

证券代码：603061

证券简称：金海通

天津金海通半导体设备股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-004

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场访谈 ☐ 其他 ☐ 线上分析师会议 ☒ 业绩说明会 ☒ 路演活动 ☐ 线上调研
参与单位名称	特定对象调研、路演活动：易方达基金、嘉实基金、光大证券资管、百年保险资管、富国基金、申万菱信、交银施罗德、鹏华基金、景顺长城、南方基金、长盛基金、天弘基金、淡水泉、泰康基金、淳厚基金、重阳资本、东吴证券、广发证券、国金证券、中邮证券、招商证券、天风证券、光大证券、中泰证券、上海证券、天瑞万合、盘京投资（以上排名不分先后）； 业绩说明会：参与业绩说明会的投资者； 网上集体接待日活动：参与活动的投资者。
时间	2025 年 8 月 29 日至 9 月 11 日
地点	特定对象调研、路演活动：公司会议室、腾讯会议、策略会现场等； 业绩说明会：上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com ）； 网上集体接待日活动：“全景路演”网站（ http://rs.p5w.net ）。
上市公司接待人员姓名	特定对象调研、路演活动：副总经理兼董事会秘书刘海龙先生； 业绩说明会：董事长、总经理崔学峰先生、独立董事孙晓伟先生、副总经理兼董事会秘书刘海龙先生、财务总监黄洁女士； 网上集体接待日活动：副总经理兼董事会秘书刘海龙先生。
投资者关系活动主要内容	一、公司介绍主要内容 金海通的主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售，

要内容介绍	客户群体涵盖半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM 企业（半导体设计制造一体化厂商）、芯片设计公司等。公司产品在集成电路封测行业有较高的知名度和认可度，产品遍布中国大陆、中国台湾、东南亚、欧美等全球市场。 公司自成立以来，一直坚持深耕集成电路测试分选机的研发、生产和销售。公司深耕平移式测试分选机领域，产品根据可测试工位、测试环境等测试分选需求分为 EXCEED-6000 系列、EXCEED-8000 系列、EXCEED-9000 系列、SUMMIT 系列、COLLIE 系列、NEOCEED 系列等。 公司的核心技术集中于“高速运动姿态自适应控制技术”、“高兼容性上下料技术”、“高精度温控技术”、“芯片全周期流程监控技术”等领域。公司产品的软件定制化程度高，集成程度高，反馈速度快，技术支持响应度好；产品的 UPH（单位小时产出）、Jam rate（故障停机率）、可并行测试最大工位等指标已达到同类产品的国际先进水平。 二、公司 2025 年上半年经营情况介绍 2025 年上半年，公司所在的半导体封装和测试设备领域需求回暖，三温测试分选机及大平台超多工位测试分选机（针对于效率要求更高的大规模、复杂测试）需求持续增长，公司测试分选机产品销量实现较大提升。公司 2025 年上半年实现营业收入 3.07 亿元，较上年同期增长 67.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,600.55 万元，较上年同期增长 91.56%；2025 年上半年，公司实现剔除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润 8,347.62 万元，较上年同期增长 108.10%；截至 2025 年 6 月末，公司总资产为 17.90 亿元，较上年末增长 11.96%；截至 2025 年 6 月末，公司净资产为 14.18 亿元，较上年末增长 7.77%。 产品方面，2025 年上半年，公司持续跟进集成电路测试分选行业细分领域头部客户的前瞻性的测试分选需求，持续对现有产品在温度控制、并测工位、可测试芯片尺寸、上下料方式和压力控制等方面进行技术研发和产品迭代。2025 年上半年，EXCEED-9000 系列产品（EXCEED-9800 系列、EXCEED-9032 系列）设备销售收入比重进一步提升至 51.37%，2024 年为 25.80%。 公司适用于 MEMS 的测试分选平台、适用于碳化硅及 IGBT 的测试分选平台以及专用于先进封装产品的测试分选平台已经在多个客户现场进行产品验证。同时，对于适用于 Memory 的测试分选平台，公司在
--------------	---

既有技术储备的基础上持续关注细分市场不断变化的测试分选需求。

公司持续加大研发投入，募投项目“半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目”按照既定计划有序推进，建成后将进一步增加公司研发及制造等综合竞争力。

市场推广方面，公司持续加大市场推广力度，不断精进全球化市场服务能力，深化客户服务。2025 年上半年，公司积极拓展新增客户群体，持续深化既有客户合作关系，全面强化客户服务能力建设。2025 年上半年，公司“马来西亚生产运营中心”启用，助力公司更好地贴近全球市场和客户、响应客户需求。

三、调研问答

1、问：2025 年上半年各系列产品占比情况如何？

答：受公司所在的半导体封装和测试设备领域需求回暖等因素影响，公司 2025 年上半年实现营业收入 3.07 亿元，较上年同期增长 67.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,600.55 万元，较上年同期增长 91.56%。2025 年上半年，EXCEED-9000 系列产品（EXCEED-9800 系列、EXCEED-9032 系列）设备销售收入比重进一步提升至 51.37%，2024 年为 25.80%。

2、问：公司产品未来升级迭代的方向？

答：公司持续深耕产品创新与技术迭代升级，不断夯实“护城河”优势，公司结合市场需求，持续对现有产品在温度控制、并测工位、可测试芯片尺寸、上下料方式和压力控制等方面进行技术研发和产品迭代。公司持续跟进集成电路测试分选行业细分领域头部客户的前瞻性的测试分选需求，通过深度定制化开发掌握并持续积淀特定细分领域芯片测试分选的前沿技术，持续扩容公司动态演进的技术储备池。公司适用于 MEMS 的测试分选平台、适用于碳化硅及 IGBT 的测试分选平台以及专用于先进封装产品的测试分选平台已经在多个客户现场进行产品验证。同时，对于适用于 Memory 的测试分选平台，公司在既有技术储备的基础上持续关注细分市场不断变化的测试分选需求。

3、问：公司在供应链安全方面有什么策略？

答：公司主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售。公司生产所需主要原材料主要为国内供应商、代理商或贸易商提供，其中部分涉及进口品牌，但主要生产地在中国大陆，同时，上述原材料能

	找到提供同类产品的国产厂商进行替代。 4、请问公司更新下对外投资的近况？ 答：公司在继续加大技术开发和自主创新力度的同时，也通过对外投资方式积极布局重点关注的技术方向，截至目前公司已参股投资了 5 家公司： （1）半导体晶圆级分选封测和平板级封装贴晶机设备及方案提供商——深圳市华芯智能装备有限公司，公司主要产品为晶圆级分选机 Wafer to tape&reel（晶圆到卷带）、IGBT KGD（已知良好芯片）分选机； （2）光通信和半导体设备提供商——苏州猎奇智能设备股份有限公司，公司主要产品为固晶机、耦合设备、测试设备等光通信和半导体设备； （3）芯片动态老化测试设备以及解决方案的提供商——芯诣电子科技（苏州）有限公司，公司主要产品为动态逻辑老化测试一体机、PXI 板卡及小型化仪表等动态老化测试设备； （4）芯片贴片机及相关服务提供商——鑫益邦半导体（江苏）有限公司，公司主要产品为超薄存储器芯片的贴片机和针对传统封装的高速贴片机； （5）射频测试仪器、射频测试机及板卡、云平台提供商——瑞玛思特（深圳）科技有限公司，公司主要产品为射频测试仪器、射频测试机及板卡及相关云平台。 四、业绩说明会问答 1、问：公司研发投入 2,206 万元，同比增长 14.02%，用于 MEMS、碳化硅 (SiC)、IGBT 等测试分选平台。这些新产品的研发进展、市场推广计划以及预期对公司业绩的贡献如何？“马来西亚生产运营中心”的启用对公司全球化战略的具体支撑作用是什么？未来在国际市场拓展方面还有哪些布局？ 答：公司持续深耕产品创新与技术迭代升级，不断夯实“护城河”优势，公司结合市场需求，持续对现有产品在温度控制、并测工位、可测试芯片尺寸、上下料方式和压力控制等方面进行技术研发和产品迭代。公司持续跟进集成电路测试分选行业细分领域头部客户的前瞻性测试分选需求，通过深度定制化开发掌握并持续积淀特定细分领域芯
--	---

	片测试分选的前沿技术，持续扩容公司动态演进的技术储备池。公司在积极开拓境内市场的同时，公司将重点跟进境外头部 IDM、OSAT 以及设计公司等头部企业快速迭代的产品及测试分选需求。公司“马来西亚生产运营中心”助力公司更好地贴近全球市场和客户、响应客户需求。 2、问：报告期内营业收入同比增长 67.86%，但应收账款/营业收入比值达 153.31%，且持续增长。应收账款增速显著高于营收增速的原因是什么？这是否与行业结算特点、公司信用政策或客户结构变化有关？管理层如何加强应收账款管理和优化现金流（报告期经营活动净现金流/净利润比为 0.22）？ 答：2025 年上半年，随着销售收入规模扩大，公司应收账款余额在一定程度上有所增加。公司系专用设备制造厂商，主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售。公司已建立了完善的客户信用政策管理制度，并综合考虑客户合作关系、资信状况、销售产品情况、合同交易金额及业务重要性等因素与客户进行商业谈判，最终确定具体合同约定账期。客户结合合同约定及与公司的合作情况进行款项支付，公司相关安排符合商业惯例。公司一直高度重视应收账款管理，已建立完善的应收账款管理制度，并积极推进应收账款回款工作。 3、问：公司营收和净利润均实现高增长，这主要是由哪些具体产品（如三温测试分选机、大平台超多工位测试分选机）、下游应用领域或客户需求驱动的？半导体测试设备市场的回暖趋势是否具有可持续性？公司如何应对可能的市场波动？ 答：2025 年上半年，公司所在的半导体封装和测试设备领域需求回暖，三温测试分选机及大平台超多工位测试分选机（针对于效率要求更高的大规模、复杂测试）需求持续增长，公司测试分选机产品销量实现较大提升。公司 2025 年上半年实现营业收入 3.07 亿元，较上年同期增长 67.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,600.55 万元，较上年同期增长 91.56%。公司从产业端感知，目前三温测试（涵盖低温测试）分选需求主要由车规级芯片的测试需求驱动；公司大平台超多工位测试分选机（针对于效率要求更高的大规模、复杂测试）可测试分选的芯片种类范围较广，涵盖消费电子、智能互联、5G 等领域中应用的芯片（公司产品应用于某类芯片测试分选的具体情况系客户公司经营行为）。公司持续加大市场推广力度，不断精进全球化市场服务能
--	---

	力，深化客户服务。 4、问：今年上半年业绩增长有哪些原因导致呢？ 答：2025 年上半年，公司所在的半导体封装和测试设备领域需求回暖，三温测试分选机及大平台超多工位测试分选机（针对于效率要求更高的大规模、复杂测试）需求持续增长，公司测试分选机产品销量实现较大提升。公司 2025 年上半年实现营业收入 3.07 亿元，较上年同期增长 67.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,600.55 万元，较上年同期增长 91.56%。 五、网上集体接待日活动问答 问：今年上半年业绩增长有哪些原因导致呢？ 答：2025 年上半年，公司所在的半导体封装和测试设备领域需求回暖，三温测试分选机及大平台超多工位测试分选机（针对于效率要求更高的大规模、复杂测试）需求持续增长，公司测试分选机产品销量实现较大提升。公司 2025 年上半年实现营业收入 3.07 亿元，较上年同期增长 67.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,600.55 万元，较上年同期增长 91.56%。
附件清单 （如有）	无
风险提示	以上如涉及公司所处行业发展趋势、公司发展规划等相关内容，不代表公司或公司管理层对行业发展、公司发展或业绩的预测和承诺，不构成公司或公司管理层对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
日期	2025 年 9 月 11 日